

문서번호: 제2017-12-01호

수 신:

참 조:

발 신: 테크포럼(주)

제 목: '고효율 방열/내열 소재/부품 세미나' 안내

1. 귀사의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 테크포럼은 12월 13일(수) 오전 10시에 한국기술센터 16층 국제회의실에서 '고효율 방열/내열 소재/부품 세미나' 를 개최합니다.
3. 본 세미나에 많은 관심과 참여 부탁드립니다.

- 아 래 -

- 가. 행사명: 고효율 방열/내열 소재/부품 세미나
- 나. 일시: 2017년 12월 13일(수) 10시~17시
- 다. 장소: 한국기술센터 16층 국제회의장
- 라. 주최/주관: 테크포럼
- 마. 세부일정

시간	주제
10:00~10:50 [트랙1]	디스플레이용 방열시트와 다기능 접착소재의 연구동향
11:00~11:50 [트랙2]	고내열 고광택 은코팅 소재
12:00~12:50 [트랙3]	고방열 다기능성 나노 소재 기술 및 산업 현황
14:00~14:50 [트랙4]	LED분야 고방열/고내열 소재, 부품 기술개발과 적용사례 및 사업화 동향
15:00~15:50 [트랙5]	열전도성 충전재 (Thermally Conductive Filler) 기술과 개발 동향
16:00~16:50 [트랙6]	자동차 부품 방열/내열 소재 이슈와 대응 기술

※ 발표 주제 및 일정은 연사/주최측의 사정에 의해 공지 없이 변경될 수 있습니다.

바. 등록비

- A. 사전결제: 253,000원(부가세/중식/자료집/PDF 포함) - 12월 12일(수) 18시까지
- B. 현장결제: 275,000원(부가세/중식/자료집/PDF 포함)

테 크 포 럼 (주)

